

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	2024年10月13日 长江养老保险、创金合信基金、红杉资本、汇丰晋信基金、景林资产、立格资本、诺安基金、太平养老保险、银华基金、招商基金等
时间	2024年10月13日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	<p>芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。</p> <p>公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processor IP）这</p>

六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。

2024 年第二季度，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，以及逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。在此基础上，根据《2024 年第三季度业绩预告的自愿性披露公告》，公司 2024 年第三季度保持经营改善的趋势，单季度营业收入同环比均实现增长，营业收入预计 7.18 亿元，环比增长 16.96%，同比增长 23.60%。

	<p>公司预计 2024 年第三季度新签订单为 6.48 亿元，截至 2024 年第三季度末在手订单为 21.38 亿元，在手订单已连续四季度保持高位，其中预计一年内转化为收入的比例为 78.26%。公司订单情况良好，为未来的业绩转化奠定坚实基础。公司坚持高研发投入，打造竞争壁垒，以保证公司在半导体 IP 和芯片定制领域具有技术领先性。2024 年第三季度公司研发投入占营业收入比重为 43.38%，公司持续在 AIGC、智慧出行等应用领域进行战略技术布局，并推进 Chiplet 技术的研发和产业化。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年第三季度报告为准。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：端侧 AI 场景需求增长，请问公司在这个领域的布局有哪些？</p> <p>回复：基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。在端侧，我们积极布局智慧汽车、AR/VR 等增量市场，已经为多家国际行业巨头客户提供了技术和服务。目前，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过 1 亿颗，主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等 10 个市场领域，在嵌入式 AI/NPU 领域全球领先，芯原的 NPU IP 已被 72 家客户用于上述市场领域的 128 款 AI 芯片中；在 AR/VR 眼镜领域，公司已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，此外还有数家全球领先的 AR/VR 客户正在与芯原进行合作。</p> <p>问题：公司三季度设计业务收入预计同环比均实现增长，请问主要是哪些项目或者领域需求驱动？</p>

回复：根据公司 2024 年第三季度业绩预告，公司三季度芯片设计业务收入预计为 2.38 亿元，同比增长 81.26%，环比增长 23.02%，主要来自于数据处理、汽车电子等先进制程客户项目。在数据处理领域，针对日益增长的支撑 AIGC 应用的海量算力需求，公司拥有面向高性能计算的 AI GPU IP、高性能 GPU IP 和 GPGPU IP 等，满足客户广泛的人工智能计算需求；在汽车电子领域，公司已为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片的一站式定制服务，其中集成了芯原的多个半导体 IP，并符合 ISO 26262 功能安全标准，性能全球领先，目前正在与一系列汽车领域的关键客户进行深度合作，以在智慧出行领域取得更好的发展机会。

问题：请问公司近期境外业务情况如何，如何展望未来收入占比？

回复：公司始终重视扩充海内外客户资源，关注全球市场机遇，实现境内外业务同步发展，长期来看，公司境外收入占比约占整体收入的三成左右。在 2024 年上半年，公司实现境内销售收入 6.03 亿元，占营业收入比重为 64.72%；境外销售收入 3.29 亿元，占营业收入比重为 35.28%。

问题：请问公司有没有外购 IP 的计划？

回复：半导体的发展有正常的波动周期，产业下行时期是半导体 IP 行业整合的良好时机。作为半导体 IP 和一站式芯片定制服务平台的行业龙头，芯原非常适合做并购。芯原多年以来一直坚持以内部自主研发为主，在自主创新的同时适时对芯原所需的技术和团队进行准确的收购和引进、吸收再创新，在此过程中，芯原的 IP 得到了充实，芯片定制能力也逐渐变强。未来，公司将继续依托平台化公司的行业理解，积极推进产业生态建设，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购公司，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。